



HPSP

기업가치 제고 계획

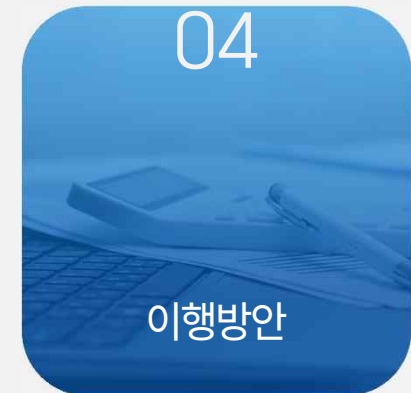
26.04.30

Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 투자미팅에서의 정보제공을 목적으로 (주) 에이치피에스피 (이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 투자미팅에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 발생할 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함 합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 투자미팅 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

★ **Table of Contents**



01 01. 기업현황

일반현황



독보적 원천기술

- 세계 최초/유일 고압 수소어닐링 기술
- 최선단공정 특화 독점 기술



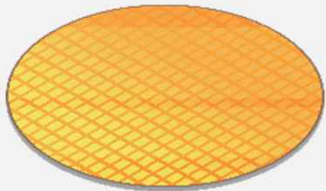
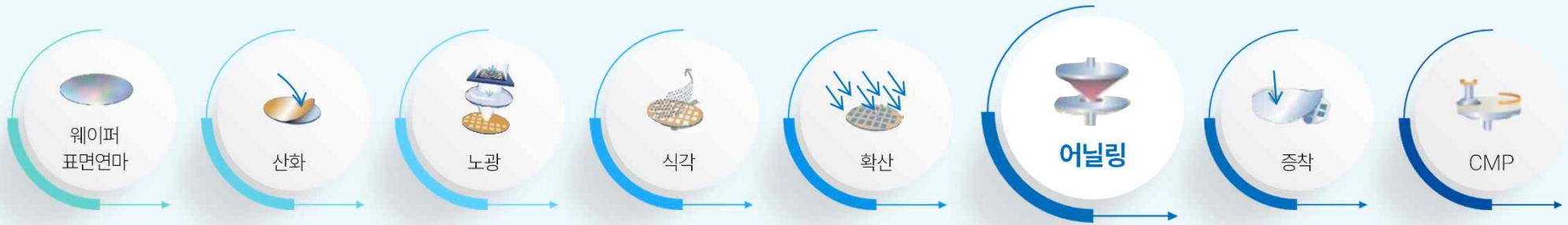
글로벌 톱티어 파운드리·메모리 고객사 확보

- 글로벌 반도체 고객 포트폴리오 구축
- 미국, 아시아, 유럽 등 글로벌 판매/서비스망 구축

회사명	(주)에이치피에스피	본사	경기도 화성시 동탄구 삼성1로1길 26
대표이사	이춘흥	임직원수	145명(본사 및 해외지사)
설립일	2017년 3월	홈페이지	http://thehpsp.com
상장일	2022년 7월 15일	발행주식수	82,300,000주
자본금	418억	주주구성 (지분율)	히트2025홀딩스(최대주주) 20.26%, 미래에셋자산운용(주) 9.55% 삼성자산운용 6.75% 등
주요제품	전공정반도체장비 (고압수소어닐링/산화장비)		

반도체 전공정 고압수소어닐링 장비를 전세계 유일하게 공급하는
고압기술의 Key Solution Provider

반도체 전공정 Process



비활성화 수소 어닐링 공정

반도체트랜지스터
구동전류및집적회로 **10~15%** ^{성능} ↑

- Transistor 소자의 「계면 결함 (Interface Defect)」을 전기적으로 비활성화 시키는 공정



비활성화 수소 어닐링 공정의 핵심장비
HPSP고압수소어닐링장비

- 공정미세화에 적합한 낮은온도 환경조성
- 계면결함비활성화공정에 최적화된 수소농도
- 글로벌독점기술을 기반한 높은 진입장벽

반도체 전공정 수소 어닐링 장비의 글로벌 리더

	고온어닐링	HPSP 고압 수소 어닐링 장비
압력	1ATM미만	1 ~ 25 ATM
공정온도	600 - 1,100°C	250 ~ 450°C
수소농도	5% 미만	100%
공정미세화	16nm 이하 적용 불가	2nm ~ 32nm 적용 중
진입장벽	낮음	높음

01 02. 사업 현황

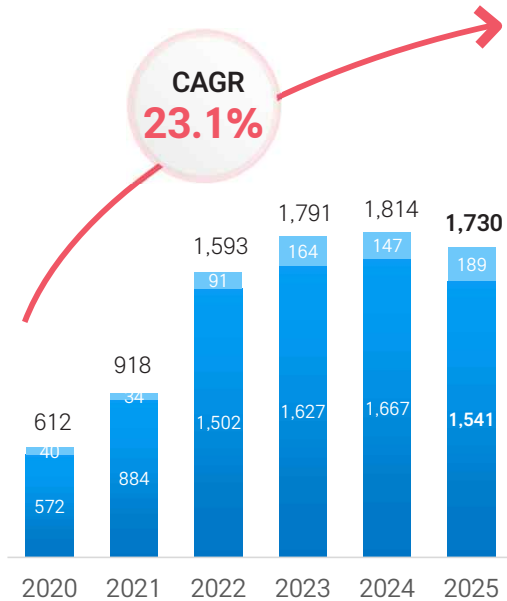
사업 현황



2022년 이후 50% 이상의 영업이익률 및 70% 이상 매출 총이익률 유지

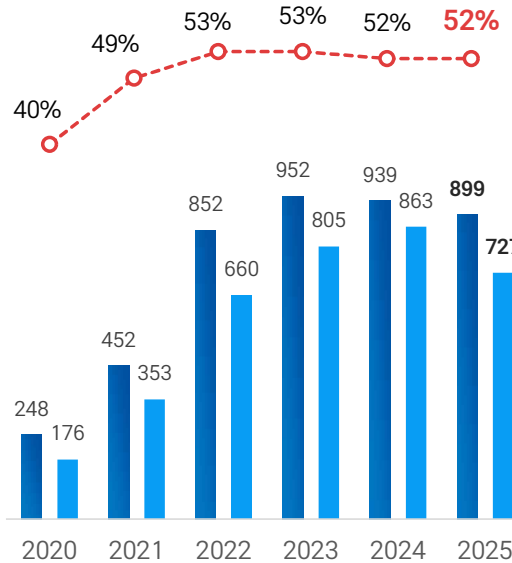
매출액 추이

■ 반도체장비 ■ 기타 (단위: 억 원)



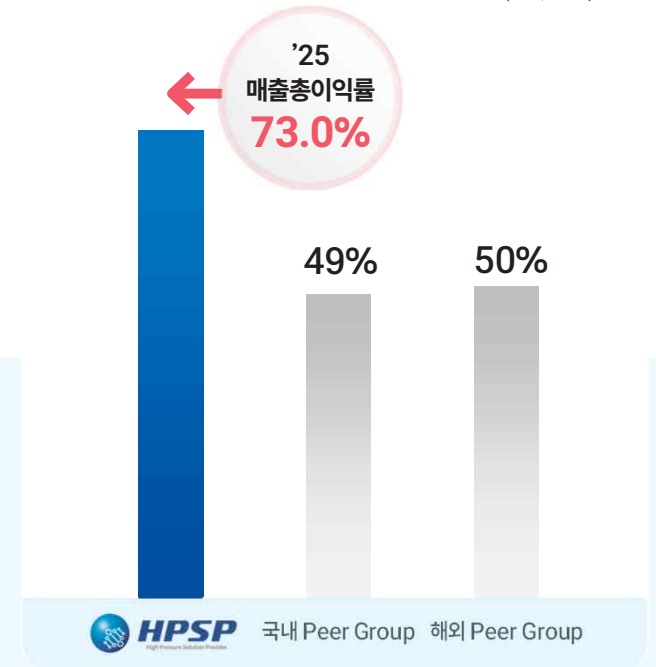
영업이익 & 순이익 지속 증가

■ 영업이익 ■ 순이익 ○ 영업이익률 (단위: 억 원,%)



5년 평균 매출 총이익률 비교

(단위: %)



Source : Company Data

01 02. 사업 현황

사업 현황



(단위:백만원)

(단위:백만원)

요약재무상태표			
구분	2023년말	2024년말	2025년말
유동자산	275,836	237,712	289,037
비유동자산	44,851	82,185	80,669
자산총계	320,687	319,896	369,706
유동부채	41,554	40,960	60,742
비유동부채	2,053	1,025	734
부채총계	43,607	41,986	61,476
자본금	41,422	41,607	41,805
기타불입자본	59,043	61,218	62,111
자본조정	1,859	-78,347	-73,607
이익잉여금	174,756	253,433	277,921
자본총계	277,080	277,911	308,230
유동비율	664%	580%	476%
부채비율	16%	15%	20%
현금및현금성자산	2,300억	1,900억	2,400억

요약손익계산서			
구분	2023년	2024년	2025년
매출액	179,087	181,402	172,964
매출원가	60,498	51,790	46,674
매출총이익	118,589	129,612	126,290
%	66%	71%	73%
판매관리비	23,382	35,666	36,388
영업이익	95,206	93,946	89,902
%	53%	52%	52%
기타수익	3,420	14,441	2,174
기타비용	2,093	1,800	2,969
금융이익	7,862	7,335	5,304
금융원가	171	102	59
세전이익	104,224	113,819	94,352
법인세비용	23,792	27,539	21,689
당기순이익	80,432	86,280	72,663
%	45%	48%	42%

01 Value-up 목표

03. Value-Up 목표



글로벌 반도체 장비기업으로 도약을 위한 주주가치 제고 목표

01



주주 환원

적극적 주주환원 정책 유지 목표

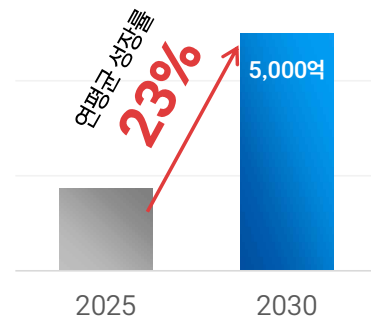


02



장기 매출

2030년 고압수소어닐링
매출 5,000억 목표

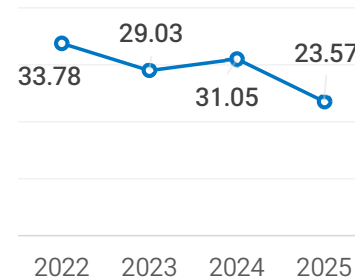


03



재무 지표

ROE 25% 이상
('26~'30 사업연도 평균)



04



ESG

ESG경영체계 수립

- E** 탄소 중립 및 온실가스 감축 방향 추진
- S** 지속적 고용창출
안전보건(안전보건 교육, 비상대응 훈련 등 안전보건 관리 활동 적극 진행)
사회공헌(기부활동 등)
- G** 이사회 독립성/전문성/다양성 확대

01 04. 이행방안

적극적인 주주환원 정책 시행



주주가치 제고를 위한 주주환원 정책

- 2024, 2025년 적극적인 배당정책 시행
- 2026년 2월 주식소각(보통주 1,699,120주) 시행

배당지표	2023년	2024년	2025년
매출액	1,791억원	1,814억원	1,730억원
영업이익	952억원	939억원	899억원
당기순이익	804억원	863억원	727억원
주당배당액	150원	600원	500원
배당성향	9.3%	55.9%	55.7%

02 04. 이행방안

사업경쟁력 강화



매출확대 기반 마련 / 글로벌 반도체 장비기업으로 도약



1. 시장 및 고객 포트폴리오 다변화

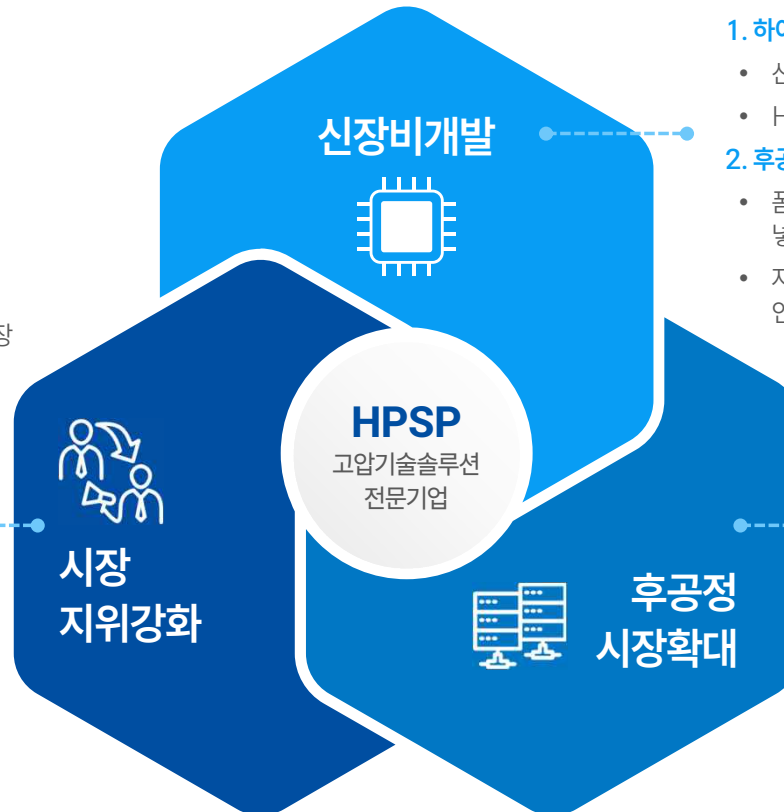
- 메모리 반도체 적용 확대 : DRAM 및 NAND 적용 처 확장
- 신규 시장 진출 (전력 반도체 및 태양전지 분야)

2. 기술 및 법적 진입장벽 강화

- 특허 포트폴리오 강화

3. 운영 효율성 및 서비스 차별화

- 데이터 기반 스마트 열처리 : AI와 데이터를 결합해 품질을 예측하고 공정 조건을 최적화하는 '디지털 전환(DX)' 기술을 장비에 탑재 목표
- 현지 대응력 강화 : 글로벌 반도체 허브 (미국, 대만, 중국, 일본등)에 기술 지원 센터를 강화하여 실시간 유지보수 및 맞춤형 공정 솔루션을 제공



1. 하이브리드 고압 공정 장비 개발

- 산소(O2), 질소(N2), 불소(F) 등을 고압을 활용한 공정 장비 개발
- Higher Pressure & Higher Temperature

2. 후공정 전용 장비 개발

- 폼팩터 변화: 웨이퍼 수납 장이 아닌, 패키징이 완료된 모듈을 대량으로 넣을 수 있는 대형 챔버 장비 개발
- 자동화 라인 연동: 후공정 자동화 설비와 즉시 연결 가능한 인라인(In-line) 시스템을 구축 가능한 장비 개발

1. HBM 적층 공정의 기술적 결함 솔루션 제공

- 고온 Bonding에 의한 휘어짐(Warpage)이나 물리적 손상을 고압공정을 활용하여 극복
- OSAT(외주 반도체 패키지 테스트) 기업 공략

2. 칩렛(Chiplet) 및 이종 집적 (Heterogeneous Integration) 최적화

- 통합 열처리 솔루션 제공
- 신규 가스 고압 처리 솔루션 제공

03 04. 이행방안 지속가능경영_ESG경영체계 수립



04 04. 이행방안

주주와의 소통 강화

정보의 비대칭성 해소를 위한 적극적인 소통



HPSP기업가치 제고 계획

감사합니다.